



2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年7月31日

上場会社名 株式会社トーマンデバイス 上場取引所 東
 コード番号 2737 URL <http://www.tomendevices.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 妻木 一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 原 英記 TEL 03-3536-9150
 四半期報告書提出予定日 2019年8月13日 配当支払開始予定日 -
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第1四半期	56,146	15.1	988	△21.4	927	△6.3	677	22.7
2019年3月期第1四半期	48,763	△7.8	1,256	42.3	990	18.0	552	△6.6

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 541百万円 (△14.2%) 2019年3月期第1四半期 631百万円 (△11.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第1四半期	99.59	90.01
2019年3月期第1四半期	81.19	71.65

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2020年3月期第1四半期	98,454	29,207	29.5	4,269.46
2019年3月期	79,694	29,278	36.5	4,280.46

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 29,038百万円 2019年3月期 29,113百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	-	0.00	-	90.00	90.00
2020年3月期	-	-	-	-	-
2020年3月期 (予想)	-	0.00	-	90.00	90.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	210,000	△3.5	3,000	△15.0	2,650	0.4	1,910	0.4	280.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料6ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご参照下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2020年3月期1Q	6,802,000株	2019年3月期	6,802,000株
② 期末自己株式数	2020年3月期1Q	611株	2019年3月期	611株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年3月期1Q	6,801,389株	2019年3月期1Q	6,801,389株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	6
3. 補足情報	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、製造業を中心とした輸出の伸び悩みに伴う下振れから景況感は悪化したものの、国内需要には底堅さがみられ、設備投資は増加傾向が継続しているほか、個人消費も人手不足の深刻化の対応などにより所得環境が改善し、緩やかに回復しております。また、世界経済においては、昨年度上昇基調であったシリコンサイクルの変化、中国のデレバレッジ政策など複数のマイナス要因が重なり減速感が強まる状況が続いております。

エレクトロニクス業界におきましては、米中貿易摩擦を背景とした最終製品需要の不透明感が、在庫調整・生産調整と単価下落を引き起こし、市況が悪化しております。また、スマートフォン需要の頭打ちに加え、データセンター向けサーバー投資の一巡により、価格の下落が続いているメモリー市場は減速傾向が継続しております。

このような状況下、当社グループは、メモリー等の価格下落が継続するなか、ストレージビジネスの拡大、また、昨年度、丸文セミコン株式会社の事業を譲受けたことにより、ファウンドリービジネス等新たな分野の売上への貢献、海外では引き続き高精細カメラCIS（CMOSイメージセンサー）を拡販したことから、売上高は561億46百万円（前年同期比15.1%増）となりましたが、メモリー価格の下落等、当社グループを取り巻く市場環境は厳しく、営業利益は9億88百万円（同21.4%減）、経常利益は9億27百万円（同6.3%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は6億77百万円（同22.7%増）となりました。

なお、品目別の実績については、6ページの「3. 補足情報（品目別販売実績）」をご参照ください。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の財政状態は、特に現金及び預金、商品および前受金が増加しました。

中国においてNAND Wafer等のビジネスの拡大に伴い商品が増加（113億46百万円）したことにより資金が減少しましたが、ファウンドリービジネスに係る前受金が増加（192億33百万円）したことにより資金が増加し、その結果、現金及び預金が増加しました。

総資産の残高は984億54百万円（前連結会計年度末比23.5%増）となりました。これは主に現金及び預金および商品が増加したことによるものです。

負債の残高は692億46百万円（同37.4%増）となりました。これは主に前受金が増加したことによるものです。

純資産は292億7百万円（同0.2%減）となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金の支払によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2019年4月26日に発表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,161	10,637
受取手形及び売掛金	47,632	48,042
商品	11,868	23,215
前渡金	11,603	12,888
預け金	2,581	1,002
その他	336	1,196
流動資産合計	78,184	96,983
固定資産		
有形固定資産	46	79
無形固定資産	253	237
投資その他の資産	1,209	1,154
固定資産合計	1,509	1,470
資産合計	79,694	98,454
負債の部		
流動負債		
買掛金	29,278	31,892
短期借入金	5,882	3,522
未払法人税等	354	297
前受金	3,119	22,352
賞与引当金	128	65
未払金	10,419	10,075
その他	805	608
流動負債合計	49,987	68,815
固定負債		
退職給付に係る負債	389	392
その他	38	38
固定負債合計	428	431
負債合計	50,416	69,246
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,054	2,054
資本剰余金	1,984	1,984
利益剰余金	24,398	24,463
自己株式	△1	△1
株主資本合計	28,435	28,500
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	273	210
繰延ヘッジ損益	△20	33
為替換算調整勘定	424	293
その他の包括利益累計額合計	677	537
非支配株主持分	165	169
純資産合計	29,278	29,207
負債純資産合計	79,694	98,454

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第1四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 2018年4月1日 至 2018年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年6月30日）
売上高	48,763	56,146
売上原価	46,845	54,454
売上総利益	1,918	1,691
販売費及び一般管理費	662	703
営業利益	1,256	988
営業外収益		
受取利息	0	4
受取配当金	6	7
持分法による投資利益	—	31
その他	1	2
営業外収益合計	9	46
営業外費用		
支払利息	74	45
債権売却損	13	4
為替差損	169	50
持分法による投資損失	12	—
その他	5	6
営業外費用合計	275	106
経常利益	990	927
税金等調整前四半期純利益	990	927
法人税等	428	240
四半期純利益	561	686
非支配株主に帰属する四半期純利益	9	9
親会社株主に帰属する四半期純利益	552	677

（四半期連結包括利益計算書）

（第1四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 2018年4月1日 至 2018年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年6月30日）
四半期純利益	561	686
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△20	△62
繰延ヘッジ損益	△55	53
為替換算調整勘定	145	△136
その他の包括利益合計	69	△145
四半期包括利益	631	541
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	615	537
非支配株主に係る四半期包括利益	15	4

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

3. 補足情報

(品目別販売実績)

品目別	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)		増減率 (%)	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
メモリー	27,608	56.6	28,784	51.3	4.3	134,496	61.8
システムLSI	13,298	27.3	16,222	28.9	22.0	49,163	22.6
半導体小計	40,906	83.9	45,006	80.2	10.0	183,659	84.4
液晶デバイス	4,517	9.2	6,198	11.0	37.2	20,413	9.4
その他	3,340	6.9	4,942	8.8	47.9	13,560	6.2
合計	48,763	100.0	56,146	100.0	15.1	217,632	100.0

(メモリー半導体)

DRAM、NAND FLASH等の供給緩和により継続して価格は下落しているものの、新規顧客開拓や既存ビジネスのシェア拡大によりPCおよびサーバー・ストレージ向けにDRAM・SSDの売上が堅調であったこと、また、中国においてNAND Waferの売上が好調であったことから、この分野の売上高は287億84百万円(前年同期比4.3%増)となりました。

(システムLSI)

国内市場でタブレット向けDDIの売上が増加したこと、昨年度、丸文セミコン株式会社の事業を譲受けたことにより、新たにファウンドリービジネス向けのSoCの販売が売上に貢献したこと、中国において引き続きスマートフォン向けにCISの販売が売上が牽引し、この分野の売上高は162億22百万円(同22.0%増)となりました。

(液晶デバイス)

液晶パネルの市況は継続して悪化しており、モニター向けの売上は減少したものの、国内・海外市場共にテレビ向けの売上が回復したことから、この分野の売上高は61億98百万円(同37.2%増)となりました。

(その他)

MLCCの市況が供給過多により悪化しておりますが、国内市場では有機ELパネルがスマートフォンの新モデルに採用されたことから、この分野の売上高は49億42百万円(同47.9%増)となりました。

(ご参考)

「メモリー」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

DRAM、NAND FLASH、MCP(マルチチップ・パッケージ)、SSD(ソリッドステートドライブ)等

「システムLSI」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

SoC(システム・オン・チップ)、DDI(ディスプレイドライバーIC)、CIS(CMOSイメージセンサー)等

「液晶デバイス」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LCD(液晶パネル)等

「その他」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LED、有機EL、MLCC(積層セラミックコンデンサ)、バッテリー等